

南臺科技大學 104 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	電子構裝技術
課程編碼	30D1BA01
系所代碼	03
開課班級	四技晶片四甲
開課教師	張文俊
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	三 2 3 4 教室 P201
必選修	選修
課程概述	本課程將會介紹積體電路電子產品所涉及的各種電子構裝製程技術及演進, 我們會討論自晶片以迄系統構裝的層次架構, 每一構裝層次的製程技術需求與 構裝元件的材料需求。
課程目標	培養學生具有電子構裝技術與材料的基本概念, 瞭解不同電子構裝元件之設計與所需求之材料特性。
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.封裝技術與發展簡介 2.IC 封裝製程 3.IC 封裝元件的分類 4.封裝材料的介紹 5.新世代封裝技術 6.IC 元件的挑戰/發展 7.3D IC 製程介紹
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.Overview of packaging technology and development 2.IC packaging process 3.Classification of IC packaged devices 4.Packaging materials 5.New-era packaging technology 6.Challenge and development of IC device 7.Introduction to 3D IC process
教學方式	
評量方法	
指定用書	
參考書籍	
先修科目	VLSI 設計概論, 電子學, VLSI 製程
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語

授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	